

Jahresbericht 2024

TK 47, Halbleiterbauelemente

Vorsitz: vakant
Sekretariat CES: Michael Good, Fehraltorf

Im Berichtsjahr fand keine Sitzung des TK 47 statt. Insgesamt wurden 230 Dokumente aus IEC an das TK verteilt. Die 99 Stellungnahmen erfolgten auf dem Korrespondenzweg. Das TK besteht aktuell aus 8 Mitgliedern.

Im Jahr 2024 wurden folgende 9 Normen publiziert:

- **SN EN IEC 60749-5:2024** Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 5: Steady-state temperature humidity bias life test
- **IEC 62047-44:2024** Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 44: Test methods for dynamic performances of MEMS resonant electric-field-sensitive devices
- **IEC 62047-43:2024** Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 43: Test method of electrical characteristics after cyclic bending deformation for flexible micro-electromechanical devices
- **IEC 62047-48:2024** Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 48: Test method for determining solution concentration by optical absorption using MEMS fluidic device
- **IEC 62047-47:2024** Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 47: Silicon based MEMS fabrication technology - Measurement method of bending strength of microstructures
- **IEC 60747-15:2024** Semiconductor devices - Part 15: Discrete devices - Isolated power semiconductor devices
- **IEC 60747-16-9:2024** Semiconductor devices - Part 16-9: Microwave integrated circuits - Phase shifters
- **IEC 63378-2-1:2024** Thermal standardization on semiconductor packages - Part 2-1: 3D thermal simulation models of semiconductor packages for steady-state analysis - Discrete packages
- **IEC 60747-5-4:2022/A1:2024** Amendment 1 - Semiconductor devices - Part 5-4: Optoelectronic devices - Semiconductor lasers

Das TK 47 ist aktuell mit 3 Experten in 4 internationalen Arbeitsgruppen vertreten.

(M. G.)